

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2026-014

## 浙江亨通控股股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司	18,000.00万元	69,664.58万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	97,664.58
对外担保逾期累计金额占最近一期经审计净资产的比例(%)	28.60

担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%  
 □ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
 □ 同时合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产50%  
 √ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

特别风险提示(如有请勾选)

其他风险提示(如有)

一、担保情况概述  
 (一)担保的基本情况

为保证全资子公司亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司(以下简称“亨通铜箔”)经营发展资金需求,浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与中国工商银行股份有限公司德阳分行(以下简称“工商银行德阳分行”)签署了《最高额保证合同》(编号:0230500022-2026年营业(保)字0004号),为亨通铜箔向工商银行德阳分行申请的流动资金贷款18,000.00万元提供连带责任保证。上述担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司第九届董事会第二十七次会议和2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司为全资子公司亨通铜箔提供担保额度不超过人民币150,000万元的担保,并授权公司董事长或其授权代表在担保额度内,办理具体的签署事项。具体内容详见公司于2025年12月13日和2025年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-062)和《2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-072)。

本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
 (一)基本情况

被担保人类别	法人
被担保公司名称	亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司
被担保人类别及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	张卫强
统一社会信用代码	91510600MA7EDEM174
成立日期	2021年12月8日

注册地	四川省德阳市旌阳区八角井街道雒山路888号(南顺路与雒山路交汇西南角)	
注册资本	60,000万元	
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
经营范围	一般项目:电子专用材料制造;新材料技术研发;金属材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;电子专用材料销售;金属材料销售;技术进出口;货物进出口;有色金属压延加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	200,179.76	143,984.02
负债总额	159,153.01	108,166.54
资产净额	41,026.75	35,817.48
营业收入	87,090.93	68,283.62
净利润	-5,294.73	-11,672.81

注:上表合计数据与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、担保协议的主要内容

保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的汇率损失)、借方根据本合同约定行使担保权利所产生的交易费用等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司亨通铜箔提供担保,有助于满足其经营发展资金需求,推进公司转型发展,符合公司及全体股东的利益。本次担保金额未超过公司董事会授权的担保额度范围。被担保人亨通铜箔生产经营正常,资信状况良好,公司为其提供担保的风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年12月11日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展,符合公司整体发展战略,不会对公司的正常运营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为97,664.58万元,占公司2024年度经审计净资产的28.60%,均为公司对下属控制企业的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会  
2026年3月26日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2026-013

## 浙江亨通控股股份有限公司关于全资子公司投资建设复合箔材项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2026-004

## 北京星网宇达科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月24日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第九次会议通知,公司第五届董事会第九次会议于2026年3月25日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议由董事长迟家升先生主持,公司高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和北京星网宇达科技股份有限公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会与会董事认真审议,作出决议如下:

1.审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

董事会同意子公司北京星网宇达科技开发有限公司向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请最高使用额度不超过1,000.00万元的银行授信,期限12个月,公司提供连带责任保证;北京星网宇达科技开发有限公司向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请最高使用额度不超过500.00万元的银行授信,期限12个月,公司提供连带责任保证;北京星网宇达科技开发有限公司向北京经济技术开发区分行申请最高使用额度不超过300.00万元的银行授信,期限12个月,公司提供连带责任保证。用途均为日常生产经营周转。本次子公司申请银行授信,有利于解决子公司经营与发展的资金需要和助力实际业务开展,提高盈利水平,符合公司整体的发展战略。子公司北京星网宇达科技开发有限公司、子公司北京星网宇达科技开发有限公司、子公司北京星网宇达科技开发有限公司,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

被担保人与公司关系:星网宇达为公司之全资子公司  
 被担保人主要财务数据:

主要财务指标	2025.09.30(2025年1-9月)	2024.12.31(2024年度)
资产总额	79,700.62	78,260.40
负债总额	15,444.36	13,517.76
净资产	64,256.26	64,742.64
营业收入	3,979.97	4,279.99
营业利润	-633.35	483.75
净利润	-486.38	467.10

(二)星网宇达基本情况

被担保单位名称:北京星网宇达科技开发有限公司  
 注册资本:500万元  
 公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 成立日期:2015年6月1日  
 法定代表人:刘俊

住所:北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼5层501  
 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

被担保人与公司关系:星网宇达为公司之控股子公司  
 被担保人主要财务数据:

主要财务指标	2025.09.30(2025年1-9月)	2024.12.31(2024年度)
资产总额	79,700.62	78,260.40
负债总额	15,444.36	13,517.76
净资产	64,256.26	64,742.64
营业收入	3,979.97	4,279.99
营业利润	-633.35	483.75
净利润	-486.38	467.10

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会  
2026年3月26日

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2026-005

## 北京星网宇达科技股份有限公司关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 案件所处的诉讼阶段:案件已经一审判决;案件二已立案。
- 公司(子公司)所处的当事人地位:案件一,公司为原告;案件二,公司为被告。
- 涉案金额:案件一涉案金额合计人民币1,038.81万元(包括57项设备赔偿款1,023.85万元,上海景峰制药有限公司(以下简称“上海景峰”)应负担的案件受理费6.46万元,上海景峰应负担诉讼费8.50万元);案件二涉案金额合计人民币1,833.82万元(包括装修款850万元,违约金242.60万元及逾期付款利息588.22万元(自2021年1月1日起,以850万元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4倍计算至实际清偿之日止,暂计至2025年11月9日),原告因本案支出的律师费153万元)。
- 对公司损益产生的影响:案件一目前已经一审判决,尚未生效,该诉讼事项对公司本期利润或后期利润的具体影响尚存在不确定性,最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。案件二尚未开庭审理,对公司本期利润或后期利润的影响尚无法做出预计。公司将密切关注上述案件后续进展,根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、诉讼情况

(一)案件一情况

近日,湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”或“景峰医药”)之子公司上海景峰收到上海市宝山区人民法院(以下简称“宝山区法院”)送达的《民事判决书》(案号:〔2024〕0113民初8244号),宝山区法院已对上海景峰与上海济药业股份有限公司(以下简称“济药业”)关于返还原物纠纷、财产损失赔偿纠纷一案作出判决。有关本案的基本情况如下:

- 原告:上海景峰制药有限公司
- 被告:上海济药业股份有限公司

2.案件基本情况

上海景峰、济药业于2021年9月6日签署《资产转让合同》,由上海景峰将其名下编号为“沪房地宝字〔2015〕第042185号”的不动产产权证转让给济药业并办理了过户手续。后针对上海景峰置放在该处所内的大批设备设施双方又于2021年10月11日签署了《设备、设施资产转让合同》并达成了共识。之后在2021年11月双方就济药业再次购买原车(201)真

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开的第五届董事会第九次会议,2026年第一次独立董事专门会议分别审议通过了《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》,同意公司向银行申请综合授信,并由子公司对本次综合授信提供担保。其中,北京星网宇达科技开发有限公司(以下简称“星网宇达”)向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请最高使用额度不超过1,000.00万元的银行授信,期限12个月,公司提供连带责任保证;北京星网宇达科技开发有限公司(以下简称“星网宇达”)向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请最高使用额度不超过500.00万元的银行授信,期限12个月,公司提供连带责任保证;北京星网宇达科技开发有限公司(以下简称“星网宇达”)向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请最高使用额度不超过300.00万元的银行授信,期限12个月,公司提供连带责任保证。用途均为日常生产经营周转。

本次子公司申请银行授信及实际担保的额度、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,本次担保经董事会审议批准后,无需提交公司董事会审议。

二、被担保基本情况

(一)星网宇达基本情况

被担保单位名称:北京星网宇达科技开发有限公司  
 注册资本:20,000万元  
 公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 成立日期:2012年5月29日  
 法定代表人:卢曙

地址:北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼3层  
 经营范围:生产导航、测量、控制、自动通讯产品;导航、测控、自动中系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子设备、机械设备(不含小汽车)、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房(房地产及地上房屋除外);不含政府审核批准的专业园、公共事业平台、孵化运营机构。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人与公司关系:星网宇达为公司之全资子公司  
 被担保人主要财务数据:

主要财务指标	2025.09.30(2025年1-9月)	2024.12.31(2024年度)
资产总额	79,700.62	78,260.40
负债总额	15,444.36	13,517.76
净资产	64,256.26	64,742.64
营业收入	3,979.97	4,279.99
营业利润	-633.35	483.75
净利润	-486.38	467.10

(二)星网宇达基本情况

被担保单位名称:北京星网宇达科技开发有限公司  
 注册资本:500万元  
 公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 成立日期:2015年6月1日  
 法定代表人:刘俊

住所:北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼5层501  
 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

被担保人与公司关系:星网宇达为公司之控股子公司  
 被担保人主要财务数据:

主要财务指标	2025.09.30(2025年1-9月)	2024.12.31(2024年度)
资产总额	79,700.62	78,260.40
负债总额	15,444.36	13,517.76
净资产	64,256.26	64,742.64
营业收入	3,979.97	4,279.99
营业利润	-633.35	483.75
净利润	-486.38	467.10

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会  
2026年3月26日

证券代码:000908 证券简称:ST景峰 公告编号:2026-037

## 湖南景峰医药股份有限公司关于公司重大诉讼的公告

公司按评估值赔偿57项设备合计10,238,520元,对应《评估明细表》第1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、34、35、36、37、38、39、41、42、43、45、46、47、48、49、57、58、59、60、61、65、66、67、68、70、76、83、84、85、91、93项设备损失;

2)驳回原告上海景峰制药有限公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费137,622元,由原告上海景峰医药有限公司负担64,629元,由被告上海济药业股份有限公司负担72,993元,评估费17万元,由原告、被告各半负担。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第二中级人民法院。

(二)案件二情况

近日,公司向苏州市吴中区人民法院(以下简称“吴中区法院”)送达的《传票》《应诉通知书》(案号:〔2025〕苏0506民初21129号),吴中区法院已对苏州深美设计咨询有限公司(以下简称“深美设计”)与上海景峰、景峰医药关于装饰装修合同纠纷一案已经立案。有关本案的基本情况如下:

- 原告各方当事人:原告:苏州深美设计咨询有限公司
- 被告一:上海景峰制药有限公司
- 被告二:湖南景峰医药股份有限公司

2.《民事判决书》基本内容

2016年3月1日,深美设计与上海景峰签署《装饰装修合同》,合同约定上海景峰将“太湖星567”装修工程“发包给原告装修,合同采取固定总价行,价格为2,400万元。2020年10

月15日,深美设计与上海景峰签署《补充协议》确定涉案工程的变更及增项金额以260万元结算,故案涉工程造价为2,660万元。

现案涉工程已装修完毕并实际投入使用,但上海景峰仅向深美设计支付了1,810万元装修款,剩余850万元装修款尚未支付,深美设计多次催讨未果。因上海景峰系法人独资企业,景峰医药系被告一唯一股东,景峰医药在无法证明其财产独立于上海景峰的情况下应当承担连带清偿责任。

3.原告诉讼请求

- 判令被告支付原告装修款850万元、违约金242.6万元及逾期付款利息588,218,889元(自2021年1月1日起,以850万元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4倍计算至实际清偿之日止,暂计至2025年11月9日);
- 判令被告支付原告需因本案支出的律师费153万元;
- 判令被告二对原告一上述诉讼请求承担连带清偿责任;
- 判令本案诉讼费由两被告承担。

除上述诉讼请求外,截至本公告披露日,公司及控股子公司存在的小额诉讼、仲裁事项主要系小额合同纠纷、劳动纠纷等,未达《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的小额诉讼、仲裁事项披露标准。

公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响

案件一目前已经一审判决,尚未生效,该诉讼事项对公司本期利润或后期利润的具体影响尚存在不确定性,最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。案件二尚未开庭审理,对公司本期利润或后期利润的影响尚无法做出预计。公司将密切关注上述案件后续进展,根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 《民事判决书》(案号:〔2024〕沪0113民初8244号);
- 《传票》《应诉通知书》(案号:〔2025〕苏0506民初21129号)。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司 董事会  
2026年3月26日

证券代码:002827 证券简称:奇正藏药 公告编号:2026-008

## 西藏奇正藏药股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到控股股东甘肃奇正实业集团有限公司(以下简称“奇正集团”)通告,获悉奇正集团所持持有本公司的部分股份被质押。奇正集团为公司控股股东,持有公司364,546,473股,占公司总股本的63.72%。具体事项如下:

1.本次股东股份质押基本情况

是否为控股股东或实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为控股股东或实际控制人	是否为质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
是	900,000	0.25%	0.16%	否	否	2026/3/24		交通银行股份有限公司西藏分行	为控股子公司融资提供担保
合计	900,000	0.25%	0.16%	-	-	-	-	-	-

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
奇正集团	364,546,473	63.72%	27,113,456	28,013,456	7.68%	4.90%	0	0
宇文化	98,395,215	17.20%	3,000,000	3,000,000	3.05%	0.52%	0	0
合计	462,941,688	80.92%	30,113,456	31,013,456	6.70%	8.42%	0	0

注:①“宇文化”为西藏宇文化发展有限公司;②以上数据若出现差异,均由四舍五入原因造成。

二、其他说明

- 本次股份质押为奇正集团为控股子公司西藏奇正青稞健康科技有限公司提供担保,同时奇正集团签署借款合同提供连带责任保证;
- 本次股份质押不存在负担保重大资产重组等业绩补偿义务;
- 截至本公告披露日,公司控股股东资信情况、财务状况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份不存在平仓或被强制平仓的风险;
- 上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将严格按照法律法规及相关监管要求,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 甘肃奇正实业集团有限公司关于将所持有的西藏奇正藏药股份有限公司股份部分质押的告知函;
- 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
- 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会  
二〇二六年三月二十六日

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司(以下简称“亨通铜箔”)拟在四川省德阳市旌阳区建设亨通精密铜箔复合箔材成果转化项目(一期)(以下简称“本项目”),本项目拟由亨通铜箔全资子公司德阳经开区亨通商业管理有限公司(以下简称“亨通商业”)代为建设厂房等基础设施,项目全面达产后预计形成年产4,500万平方米高端铜箔复合箔材生产能力。
- 投资金额:本项目总投资金额预计不超过人民币50,000万元,最终以项目建设实际投资金额为准。
- 已履行的审议程序:本次投资事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。
- 相关风险提示:
  - 1.项目风险:本项目建设过程中如遇行业政策调整、产品市场需求发生重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致项目无法如期全部建设完成。
  - 2.项目实施风险:本项目预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的估算,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程及产业化过程中会面临不确定因素影响,具体的实施进度与实施效果存在不确定性,未来产品市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。
  - 3.预期收益变化:项目建成投产,其经济效益可能受到宏观经济波动、行业政策调整、市场供需关系变化以及市场竞争加剧等多重因素影响,存在无法实现预期收益的风险。

(一)对外投资概述

1.本次交易概况

公司全资子公司亨通铜箔拟在四川省德阳市旌阳区新建亨通精密铜箔复合箔材成果转化项目(一期),拟由亨通铜箔全资子公司亨通商业代为建设厂房等基础设施,项目全面达产后预计形成年产4,500万平方米高端铜箔复合箔材生产能力。本项目总投资金额预计不超过人民币50,000万元。本次对外投资资金来源为亨通铜箔自有资金或自筹资金。

2.本次交易的基本情况

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司(□同比例,□非同比例) -增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未控股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目□其他:
投资标的名称	亨通精密铜箔复合箔材成果转化项目(一期)
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):不超过50,000 □ 尚未确定 √ 现金 √ 自有资金 □ 募集资金 √ 银行借款 √ 其他:自有资金 □ 实物资产 或 无形资产 □ 股权 □ 其他:
出资方式	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 √ 否

(二)董事会审议情况:是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年3月25日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于项目投资(议案)》,同意公司全资子公司亨通铜箔以不超过50,000万元投资建设亨通精密铜箔复合箔材成果转化项目(一期)。本次对外投资资金来源为亨通铜箔自有资金或自筹资金。该议案表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。本项议案在提交公司董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。

(三)本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。(四)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

主要财务指标

主要财务指标	2025.09.30(2025年1-9月)	2024.12.31(2024年度)
资产总额	4,724.82	4,396.21
负债总额	2,474.58	2,292.84
净资产	2,250.24	2,103.38
营业收入	1,533.95	1,638.18
营业利润	77.97	299.85
净利润	146.86	308.92

(三)尖翼科技基本情况

被担保单位名称:尖翼科技有限公司  
 注册资本:3,529.4118万元  
 公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 成立日期:2016年6月13日  
 法定代表人:李国盛

住所:北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼4层402  
 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;销售电子产品、电子产品、机械设备;委托加工人工控制装备和动力装备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人与公司关系:尖翼科技为公司之全资子公司  
 被担保人主要财务数据:

主要财务指标	2025.09.30(2025年1-9月)	2024.12.31(2024年度)
资产总额	26,503.71	30,098.52
负债总额	10,018.51	13,380.58
净资产	16,485.20	16,717.94
营业收入	278.34	1,194.36
营业利润	-306.78	-1,113.89
净利润	-232.74	-875.85

三、本次担保的主要内容

公司为星网宇达、星网宇达、尖翼科技授信事项提供担保,担保的主债权本金合计不超过1,800万元。其中,为星网宇达提供担保的主债权本金不超过1,000万元,为星网宇达提供担保的主债权本金不超过500万元,为尖翼科技提供担保的主债权本金不超过300万元。具体情况如下:

(一)星网宇达担保的主要内容

- 1.担保方式:连带责任保证
- 2.保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。
- 3.担保的主债权本金不超过1,000万元。
- 4.保证范围:借款合同项下的借款本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(二)星网宇达担保的主要内容

- 1.担保方式:连带责任保证
- 2.保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。
- 3.担保的主债权本金不超过500万元。
- 4.保证范围:借款合同项下的借款本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(三)尖翼科技担保的主要内容

- 1.担保方式:连带责任保证
- 2.保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。
- 3.担保的主债权本金不超过300万元。

(一)投资标的概况

公司全资子公司亨通铜箔拟投资建设亨通精密铜箔复合箔材成果转化项目(一期),项目自建达产后,预计形成年产4,500万平方米高端铜箔复合箔材的产能。本项目总投资金额预计不超过人民币50,000万元,资金来源为亨通铜箔自有资金或自筹资金。项目建设周期约为17个月。

(二)投资标的详细信息

(1)项目基本情况

投资类型	√ 投资新项目
项目名称	亨通精密铜箔复合箔材成果转化项目(一期)
项目主要内容	在四川省德阳市旌阳区亨通铜箔“厂新建”厂房车间、化学品库、废弃物库及相关配套设施,本项目全面达产后形成年产4,500万平方米高端铜箔复合箔材生产能力。
建设地点	四川省德阳市旌阳区雒山路888号
项目总投资金额(万元)	50,000万元(最终以项目建设实际投资为准)
上市公司投资金额(万元)	公司全资子公司亨通铜箔拟投资不超过50,000万元(最终以项目建设实际投资为准)
项目建设期(月)	17
预计开工时间	2026年3月(以实际日期为准)
是否属于主营业务范围	√ 是 □ 否

(2)投资出资情况

本项目由公司全资子公司亨通铜箔投资建设及生产运营。本次投资项目资金来源全部为亨通铜箔自有资金或自筹资金。

本项目建设周期预计17个月,目前项目正在推进中。

(3)项目市场定位及可行性分析

本项目投资建设建设的铜箔复合箔材主要应用于覆铜板、电池负极集流体、电磁屏蔽材料、电子电路等领域。本项目将依托公司自主研发的铜箔复合箔材核心技术,聚焦超薄复合箔材市场,进一步推动科技成果的产业化应用,项目的实施符合行业发展趋势与公司发展战略,项目建成后将有助于发挥亨通铜箔现有铜箔业务与市场的协同效应,提升公司在高端铜箔复合箔材领域的核心竞争力。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为亨通铜箔自有资金或自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资建设复合箔材项目有利于进一步完善公司的产业布局,拓展公司新的利润增长点,提升公司核心竞争力。

本次对外投资资金来源为亨通铜箔自有资金或自筹资金,不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资不会影响公司业务的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1.项目风险:本项目建设过程中如遇行业政策调整、产品市场需求发生重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致项目无法如期全部建设完成。

2.项目实施风险:本项目预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的估算,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程及产业化过程中会面临不确定因素影响,具体的实施进度与实施效果存在不确定性,未来产品市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。

3.预期收益变化:项目建成投产,其经济效益可能受到宏观经济波动、行业政策调整、市场供需关系变化以及市场竞争加剧等多重因素影响,存在无法实现预期收益的风险。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会  
2026年3月26日

4.保证范围:借款合同项下的借款本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、累计授信及对外担保的数量及逾期担保的数量

截至2026年3月24日,公司及子公司累计申请综合授信金额为23,440.00万元,公司为子公司提供担保金额累计为(含本次担保)3,800万元,占最近一期(2024年12月31日)经审计归属于母公司净资产169,855.12万元的2.24%。

公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第九次会议决议;
- 2.2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会  
2026年3月26日

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:20